

29/11/2000

## 科大舉辦電子材料及封裝國際研討會

香港科技大學（科大）將於11月30日至12月2日舉辦本港首個大型電子材料及封裝國際研討會(EMAP 2000)。

**電子材料及封裝國際研討會** 匯聚國際著名的電子封裝權威學者，共同就電子材料、封裝及組裝的最新進展及先進技術進行討論，交換意見。研討會由科大機械工程學系和**電子封裝實驗室**，聯同電機暨電子工程師學會電子元件封裝製造技術學會香港分會（IEEE-CPMT, Hong Kong Chapter）合辦。

科大今天(11月29日)為研討會舉行了開幕招待會，出席嘉賓包括創新科技署署長何宜威先生及科大校長吳家璋教授。美國喬治亞理工學院白德講座教授兼電子封裝研究中心主任Rao Tummala教授在招待會上發表演說。他主張政府、工業界及學術界共建伙伴關係，推行產學研結合的合作模式。



何宜威在開幕招待會上致詞。

電子封裝實驗室亦在會上向一直支持並贊助該實驗室的合作伙伴致謝。這些企業包括進盈科技（香港）、樂依文科技、先進自動器材、雅達電創、超毅電子集團、金柏科技、華科電子、飛利浦益電半導體、希普勵亞洲及偉易達電訊；其中金柏科技創辦人張志華先生大力支持科大的電子封裝研究項目，至今已投入數以百萬元。每位合作伙伴均獲贈該實驗室製造的大晶片，在顯微鏡下可見晶片由數以千計微型金屬球組裝而成。

研討會，詳情如下：

電子封裝實驗室捐贈者答謝會暨

電子材料及封裝國際研討會開幕招待會

日期：2000年11月29日（星期三）

時間：5:30 pm

地點：九龍清水灣香港科技大學學術大樓七樓觀景廳

（請乘13至15號升降機）

電子材料及封裝國際研討會

日期：2000年11月30日至12月2日

時間：9 am-5:10 pm

地點：九龍清水灣香港科技大學大學中心

語言：英語

### 科大電子封裝實驗室

電子封裝即半導體集成電路元件從製造到安裝整個過程所需的技術。隨著市場對互聯網及流動裝置的需求大增，電子封裝商業增長迅速，營業額達數以億元計。在本港，電子封裝業對大學畢業生的需求殷切，同時，業界亦需大學協助進行

技術轉移及開發。

科大電子封裝實驗室於1998年成立，是科大工業聯盟的成員之一，致力於電子封裝技術的研究及開發，配合本港集成電路封裝工業的發展需要。目前，該實驗室獲香港創新科技署及本地企業聯合資助經費達1,800萬港元，正進行兩項創新科技基金的研究項目；又獲研究資助局及多項工業撥款。科大七位學者正從事電子封裝的研究工作，他們是機械工程學系的金章教博士、林銓振博士、李世瑋博士、李漢強博士、吳景深博士及袁銘輝博士，以及電機及電子工程學系的陳正豪教授。